「面白いことをやろうぜ!」をテーマに社会貢献できる製品を提供



アステンフェーションズ 株式会社



事業・商品・技術の特徴

◇事業内容

・LSI/FPGAハードウェア開発、製品開発/製造

◇商品内容

- ・非接触掌紋認証システム 「Hand Passport」
- ·金型温度可視化 ワイヤレス通信システム「TWINDS-T」

◇技術の特徴

- ・第三者の視点で効率的・網羅的な検証サービスを提供
- ・産学官連携による最先端の研究開発及び技術開発
- ・ご要求のコンセプトから製品まで小回りある開発対応

イチ押し!車技術

◇金型温度可視化 ワイヤレス通信システム

- ・リアルタイム計測
 - -熱電対温度 0.1 秒毎計測
 - Ch 増 (8ch/台、最大 104ch) でも速度劣化なし
- グラフ表示/CSV 記録
 - ーリアルタイムグラフ表示と同時に0.1 秒単位でCSV 記録
- ·防水·防塵/小型本体
 - IP67対応、工場内使用に最適
 - 小型本体は設備の隙間に設置

◇画像アルゴリズムのFPGAソリューション

・アルゴリズムに最適にカスタマイズしてFPGAに実装、 最高性能を実現

連絡先

Tel 022-342-1888 Fax 022-342-1885

E-Mail satoshi.yamamura@takumi-solutions.com

URL https://www.takumi-solutions.com

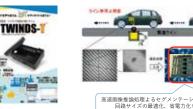
担当者役職・氏名 プロダクツ&ソリューション 山村 聡





新横浜DC

本社



金型温度 ワイヤレス 温度計測システム 「TWINDS-T」

画像アルゴリズム FPGA ソリューション

生産品目等

	車		
品目	金型温度可視化ワイヤレス通信システム「TWINDS-T]	画像アルゴリズムのFPGA 化ソリューション	
ロット	1 台から	_	
サイズ	90×50×30.5	_	
精度	0.1秒単位、0.25℃	-	
材 質	ポリカーボネート	_	
取引先	自動車部品企業他	自動車メーカ他	
売上比率(%)	10%	10%	

車以外			
ハードウェア受託 (ASIC/FPGA/PCB) 開発			
-			
-			
_			
_			
半導体企業、産業機器企業他			
60%			

生産設備

名 称	型式·能力	台数
オシロスコープ	_	4
FFTアナライザ	_	1
インサーキットエミュレータ	Cortex-M4, RL78, PIC	5
FPGA 統合開発環境	Vivado, Quartus Prime	7
FPGA 統合開発環境	Quartus Prime	1
FPGA 統合開発環境	Vivado, Quartus Prime	7
論理シミュレータ	Xcelium (IES) / VCS-MX	6
RTLデバッグツール	Verdi	1

企業概要

	正木杨文	
本 社	〒980-0014仙台市青葉区本町 GM ビルディング 2F	Ţ1-12-12
宮城の拠点	同上	
面積	【敷地】 262.46㎡ / 【建物】 26	2.46m²
海外拠点	_	
代 表 者	代表取締役 岩本 正美	
設 立	2007年 (H19)	従業員
資 本 金	1,000万円	50名
認証取得	_	
資格取得	_	

業務範囲 素 材 企画/開発 設 計 試作/ハロット 量 産 組立/検査 評 価 設備メンテ等

鋳 造 ダイカスト

鍛造

プレス

樹脂成形

ゴム成型

電装品

表面処理

縫製 · 皮革

機械加工

ばね

金型

自動機

製缶 ・ 板金

ソフト ウェア

その他